民生证券股份有限公司

关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”,“保荐机构”）作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“迅捷兴”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对迅捷兴变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目相关事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、原募集资金投资项目计划及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕961 号）同意注册，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3339 万股，发行价格为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除发行费用人民币 5,337.49 万元，实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2021]21256 号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）原募集资金投资项目

经第二届董事会第十八次会议审议，同意公司将首次公开发行募集资金净额20,005.52万元全部投入“年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目”，不足部分由公司自筹资金解决，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟投入募集资金
1	年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目	37,538.13	20,005.52
2	补充流动资金	7,500.00	0
合计		**45,038.13**	**20,005.52**

截至变更前，原募投项目尚未开工建设，尚未投入募集资金。

（三）募集资金使用情况

截至2021年8月30日，募集资金专户余额25,464,572.27元，募集资金使用情况主要为：

1、原募投项目使用金额0元；

2、闲置募集资金暂时补充流动资金0元；

3、暂时闲置募集资金用于现金管理金额17,500,000元；

4、募集资金理财收益和利息收入合计359,449.52元。

二、变更募集资金投资项目的情况说明

（一）变更后募集资金投资项目

本次变更后，募投项目基本情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟投入募集资金
1	年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目	32,314.07	20,005.52
合计		**32,314.07**	**20,005.52**

备注：最终拟使用募集资金投资金额包括利息收入及理财收益等，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

（二）变更募集资金投资项目原因

本次募集资金用途变更，主要是下游行业景气度高，客户需求旺盛，公司现有产能已无法满足订单快速增长的需要。为加快产能扩建，满足客户订单增长需求，同时加快向智能制造转型升级，公司拟将原募集资金投资项目由“年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米 HDI 板项目”变更为“年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目”，变更募集资金投资项目主要原因有：

1、突破产能瓶颈制约、加快提升产能，满足公司扩张需求

受 PCB 下游行业景气度高、客户需求旺盛的影响，公司现有的产能已无法满足订单的快速增长。原募投项目需新建厂房，存在较长的项目建设周期，预计项目投产时间需要 2-3 年左右，短期内公司发展会受限于产能扩张速度。

变更后募集资金投资项目的厂房已于 2020 年底竣工并交付使用，截至目前，该项目的规划设计以及前期调研等均已完成，预计 2022 年 6 月可开始投产。与原募投项目相比，变更后的募投项目有利于加快扩大公司的产能和提高短期内业务承接能力，更好地发挥公司规模效应，在巩固现有客户的基础上扩大客户群体，提升公司市场竞争力和盈利能力。

2、提高募集资金使用效率，加快促进公司发展

由于公司首次公开发行实际募集资金少于原募投项目资金需求，资金缺口较大。公司本次变更募集资金用途，可加快募投项目的实施从而获得投资项目收益，提高了募集资金的使用效率，进一步缓解了公司规模扩张过程中的资金压力从而加快促进公司发展，符合公司发展计划。

3、加快向智能制造转型升级需要

变更后的募投项目将利用 MES 平台集成大数据管理，采用“双辅料+大拼版”的生产方式，打造自动化互联水平更高、流程更优化、布局更科学、管理更完善的的智能化工厂，使得公司加快向智能制造转型升级。通过加快智能化工厂构建，进一步提高产线的自动化水平，降低生产成本、提高经营效率，助力公司快速步入发展快车道赶超同行。

三、变更后募集资金投资项目情况

（一）项目概况

1、项目名称：年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目

2、项目实施主体：信丰迅捷兴电路科技有限公司

3、项目性质：产能扩建项目

4、项目建设地点：江西信丰电子器件产业基地内

5、项目投资金额：

本项目预计投资金额是 32,314.07 万元，具体投资情况如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	投资比例
一	固定资产投资	27,637.93	85.53%
1	设备设施投入	26,596.29	82.31%
2	装修工程费	1,041.64	3.22%
二	预备费	1,381.90	4.28%
三	铺底流动资金	3,294.24	10.19%
四	合计	32,314.07	100.00%

本项目资金筹措计划主要为拟使用公司募集资金 20,005.52 万元及其理财收益和利息收入等，剩余不足部分，由公司使用自筹资金解决。

6、项目建设期：

项目建设期约 1 年。本项目分二期投入，因本项目厂房已于 2020 年底投入使用，无需新建厂房，项目第一期计划于 2021 年 9 月启动设备购置等，2022 年 6 月预计可实现投产，投产产能为 25000 ㎡/月；第二期项目主要增加瓶颈工序设备以扩充产能，预计第四季度可实现投产，二期项目投产后，本项目年产能可达 60 万㎡。

7、项目主要内容：

本项目将借鉴现代科技的力量建设一个“数据集成、自动互联、高效严谨、节能减排”的智能工厂，其基础是利用 MES 平台集成大数据库管理，通过工厂自动化设备互联互通，实现工厂全流程管理自动化、数字化、智能化，从而达到减

少浪费、降低成本、提高工作效率、提高产品质量等。

同时本项目将采用“双辅料+大拼版”生产方式，结合智能工厂的自动互联流程设计等，可以更有效地降低生产成本，增加单位工作板的生产面积，大幅提升工作效率，缩短生产周期，增强公司的竞争力。

本项目智能化工厂的数字化生产车间布局，将由传统的分散性向集中的精益流水线式改进，实现生产各工序设备之间如流水线式的互相关联，AGV 流转实现物流自动化，通过自动化、智能化数据驱动减少对人员依赖并大幅减少人为失误、节约人员数量，并实现信息传送零时差、决策及问题处理零等待。通过智能制造还可实现设备数据化管理，利用大数据对各工厂设备的使用寿命、稼动率、配件使用寿命、物料消耗、产量、生产工艺参数和产品的特性进行实时统计，实现系统监控和优化。该项目将使公司成功向智能制造转型升级、进一步为打造智慧型工厂奠定坚实的基础和示范。

8、项目经济效益分析：

本项目投产后可新增年产能 60 万平方米，预计项目投资内部收益率（税后）为 18.71%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.78 年，年均税后净利润为 5,036.82 万元。

（二）项目背景

1、PCB 行业持续健康发展、行业市场广阔

PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，根据 PCB 行业研究机构 Prismark 统计，2020 年全球 PCB 总产值约为 652.19 亿美元，同比增长 6.4%，全球 PCB 市场规模在未来五年仍将保持稳步增长的态势，预计到 2025 年全球 PCB 市场规模将达 863 亿美元；中国大陆 2020 年 PCB 总产值约为 350.54 亿美元，同比增长 6.4%，到 2025 年中国大陆 PCB 总产值规模预计达到 461.2 亿美元，2020-2025 年均复合增长率为 5.6%。

2、国家产业政策的大力支持

电子信息产业是我国优先发展的行业，是国民经济的战略性、基础性和先导

性支柱产业，PCB 作为电子信息产品中不可或缺的基础组件，其发展得到了国家相关产业政策的大力支持。

近年来政府出台了一系列政策，为 PCB 行业的发展提供了广阔的空间。同时，随着工业 4.0 概念和中国制造 2025 的提出和发展，促使行业不断向高端工业化、智能化发展，从而推动产业升级进步，为此建立工业智能化工厂势在必行。

3、下游应用领域的蓬勃发展催生巨大市场需求

下游行业的发展是 PCB 产业增长的动力。当前，全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术、新应用不断涌现、发展，随着 5G 网络建设的大规模推进及商用，将催化电子产品相关技术和应用更快发展、迭代、融合。由于 5G 通信基站建设量大幅增加，应用于 5G 网络的交换机、路由器、光传送网等通信设备对 PCB 的需求增加，PCB 使用量将相应增长；在通信代际更迭、数据流量爆发式增长的背景下，高速、大容量、高性能的服务器将不断发展，将会对高层数、高密度、高频高速印制电路板形成大量需求；随着电动汽车普及率提高、汽车电子化程度加深、先进驾驶辅助系统(ADAS)的渗透率正在提高以及自动驾驶技术和汽车网联化的不断发展，汽车不仅对 PCB 用量大幅提升，对高端 PCB 的需求也在迅速增长。

（1）安防电子

安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业，是社会公共安全体系的重要组成部分。围绕着视频监控技术的改革创新，行业从“看得见、看得远、看得清到看得懂”，一共经历模拟监控、数字监控、网络高清监控和智能监控 4 个阶段，每一阶段的突破，都由上游技术的革新引领。国内安防市场中，以平安城市、天网工程、雪亮工程为代表的国家安防需求驱动产品市场升级，我国基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。据中国安全防范产品行业协会出具的《中国安防行业 2018 年度统计报告》，截至 2018 年末，中国安防行业的企业总量约 3 万家，安防企业年收入总额约 6,900 亿元，相比 2017 年 6,016 亿元增长逾 14%。

随着全球政府、企业以及消费者安全意识的提高以及对安全系统付费意愿提

升，安防需求持续提高。根据研究机构 MarketsandMarkets 的预测，2019 年全球安防解决方案市场规模为 2,579 亿美元，2024 年市场规模将可达 3,976 亿美元，复合增长率达 9%。

（2）5G 通信设备

国家对新一代信息技术十分重视，在《中国制造 2025》和“十三五”规划纲要等文件中，均将 5G 技术列为战略重点发展领域。相对于“1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 同步”的发展历程，中国 PCB 企业已在 5G 领域宏基站与微基站的天线/射频模块、光通信模块、新型封装工艺等方面掌握核心技术，可以与国外企业进行高纬度竞争。随着 5G 的规模化应用，将带来电子信息产业的重大变革，从前期的宏基站与微基站建设、交换机与路由器升级、服务器与存储器置换，到后期的智能终端、大数据、人工智能、物联网等应用，为我国 PCB 企业在技术上提供赶超赛道，为 PCB 市场提供广阔的成长空间。根据中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》，按照 2020 年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4,840 亿元的直接产出，2025 年和 2030 年将分别增长到 3.3 万亿和 6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率为 29%。

（3）汽车电子

在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平日益提高，中高档轿车中汽车电子成本占比达到 28%，新能源汽车中汽车电子成本占比高达 47%。消费者对于安全类车身电子产品（如刹车辅助系统 EBA、急速防滑系统 ASR、电子稳定程序 ESP、智能泊车等）和信息娱乐类产品（如汽车音响、车载视频、倒车可视系统、车载导航）的认可度不断提高，这类产品已进入快速发展期，直接带动汽车电子市场的整体发展。

根据 Prismark 的预测，全球汽车电子将持续稳定发展，2017 年全球汽车产量为 9,730 万辆，预计 2022 年全球汽车产量将达到 10,760 万辆，全球汽车产量每年增长率约为 2.0%；2017 年每车电子含量为 2,180 美元，预计 2022 年每车电子含量将达到 2,715 美元，每车电子含量每年增长约 4.5%。根据 Prismark 的统计和预测，受全球疫情影响，2019 年全球汽车电子市场规模较 2018 年有所下降，预计 2024 年将回升至 3,060 亿美元。

（4）云计算

Prismark 数据显示，应用于服务器/数据存储的 PCB 在 2019 年产值为 49 亿美元，2020 年预计为 59 亿美元，同比增长 19.3%；到 2025 年预计为 89 亿美元，2020-2025 年年均复合增长率为 8.5%。伴随云计算的发展，云计算将不断赋能千行百业，为经济社会高质量发展提供新动能。服务器、数据存储行业对 PCB 行业的需求也将显著增长。

（5）物联网

根据 IDC 的统计，2020 年全球物联网行业的市场规模为 1.36 万亿美元，2015 至 2020 年复合增长率高达 17.39%。近年来，随着物联网核心技术不断发展，软件与系统的融合打破了设备连接的边界，全屋智能等新兴应用场景的普及，物联网下游领域的市场规模在产业建立和完善的过程中持续扩张，增量可期。

（三）项目实施必要性

1、有助于公司扩大产能，满足业务快速发展的需要

近年来，安防、汽车电子、工业控制、通讯、医疗等下游行业的快速发展催生了巨大的 PCB 需求。目前，公司生产经营场地空间日趋局促，产能无法满足快速增长的市场需求。根据公司未来业务增长趋势，在原有募投项目和珠海工厂投产前，公司发展将遭遇产能瓶颈的制约，产能的矛盾在短期内将尖锐化。

通过实施本项目，公司将在现有信丰迅捷兴场地内新增生产线开展产能扩充项目。由于无需新建厂房，缩短了投产期，从而加快了企业产能规模扩张的速度；按照公司发展计划，本项目将新增 60 万平方米印制电路板生产能力，同时公司将按照未来业务增长的实际需求，打造设施自动化水平更高、流程更优化、布局更科学、管理更完善、更具国际化水准的 PCB 智能化生产基地，使公司生产能力的瓶颈在短期内得到充分缓解，进而为业务高速增长提供坚实保障。

2、有助于提升一站式服务能力优势，增强客户粘性

公司技术能力全面，可以根据客户需求提供多样化、定制化的产品服务，产品广泛应用于下游各领域。但是，产能瓶颈是制约公司快速发展的重要因素。

目前，公司大部分客户具有从PCB样板至批量板的不同阶段产品需求，但受制于产能不足，公司无法充分满足优质客户的批量板需求。为此，公司需加快提升生产能力，持续增强一站式服务能力优势，从而更好的满足客户各类型产品需求以增强客户粘性。

3、有助于进一步提质增效，降低成本

为响应《中国制造2025》国家战略，推进智能制造，促进制造业数字化、网络化、智能化，走创新驱动的发展道路，公司紧跟时代步伐，打造智能化工厂势在必行，同时符合工业智能化发展路线。

本项目将借鉴现代科技的力量建设一个“数据集成、自动互联、高效严谨、节能减排”的智能化工厂，其基础是利用MES平台集成大数据管理，通过工厂自动化设备互联互通，实现工厂全流程管理数字化、透明化，实现传统工厂向智能制造转型升级。通过智能工厂，公司不仅可达到提高工作效率，节约人员，降低运营成本；而且可大幅缩短生产周期，增加效益，同时还大大减少了人为工作失误，通过围堵各种漏洞，提高产品质量，从而提高了公司综合竞争力。

4、有助于进一步提高核心业务竞争能力、提高市场占有率，提升行业地位和品牌影响力

公司核心业务的规模和优势是生产能力的重要指标，公司在从样板到批量板生产一站式服务领域具有综合竞争力优势。公司专注于PCB快件样板产品先进制造技术多年，积累了丰富的PCB产品开发经验，建立了完善的检验检测流程；通过国内外广泛的营销渠道建设，与行业内客户建立了互信互助的战略合作关系，从而推动公司产品销售持续稳定增长。

实施本项目将充分利用公司在通讯、安防、医疗、军工等领域印刷电路板的先进技术优势和产品的良好口碑，在巩固公司原有的竞争优势的基础上进一步扩大产品产量和销量，从而持续提升公司市场影响力和行业竞争力，提高国内外市场占有率、行业地位和品牌影响力。新募投项目将成为公司加快实现行业战略布局、培育可持续综合竞争力与提升股东回报的重要保障。

5、培养专业团队，提升人才竞争力

在日趋激烈的市场竞争环境下，积极培养、造就复合型人才团队是公司长期可持续发展的重要支撑，更是未来公司提升在 PCB 行业地位的必由之路。通过本项目的建设与运作，公司可以培养一批具有技术开发、现代管理、市场营销、品牌运作等综合能力的专业人才，为公司在 PCB 制造领域进一步发展夯实人才基础。

6、获得持续、稳定、可观的投资收益

根据投资财务评价分析，本项目建成并投入运营后将优化公司业务增长模式，可充分实现预期收益目标。据测算，项目计算期内财务内部收益率（税后）达到 18.71%，高于社会平均折现率 10%；税后静态投资回收期（含建设期）为 6.78 年，年均税后净利润为 5,036.82 万元。因此，变更后募投项目拥有良好的市场前景，公司可获取可观的投资收益和利润回报。

（四）项目实施可行性

1、本项目符合国家的产业规划和政策导向

近年来，中共中央政治局、国务院、国家相关部委及地方人民政府出台了一系列政策支持印制电路板行业的发展，引导产业转型升级和结构调整，鼓励发展 HDI 板、高频高速板、集成电路封装基板等特种工艺和特殊基材的印制电路板领域。其中，2017 年 2 月，国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》明确将“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导目录；2019 年 1 月工信部发布的《印制电路板行业规范条件》《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》提出要加强印制电路板行业管理，提高行业发展水平，引导产业转型升级和结构调整，推动印制电路板产业持续健康发展；2019 年 10 月，发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将“新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料”列为“鼓励类”发展产业。2020 年 11 月，“十四五规划”中提出要加快壮大新一代信息技术、新能源汽车、航空航天等产业，国务院及相关部委随后逐步推出了“新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）”“建设高标准市场体系行动方案”“基础电子

元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）”“5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）”等一系列产业政策支持和引导新能源汽车、5G 通讯、消费电子、物联网、工业互联网等领域的发展。

2、市场前景广阔，新增产能消化有保障

据 Prismark 统计，2019 年全球 PCB 产业总产值达 613.11 亿美元，我国 PCB 行业产值达到 329.40 亿美元。根据 Prismark 预测，未来 5 年全球 PCB 市场将保持温和增长，人工智能、5G、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。随着 5G 加速落地，通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等下游领域需求的不断增长，预计未来 PCB 市场规模仍将呈稳定增长态势。凭借公司在行业内多年的积累，新增产能的消化有可靠保障。

3、丰富的客户资源作为支撑

PCB 在连接各种元器组件中起着关键作用，是现代电子设备的重要组成部分，其性能、品质、工艺会直接影响客户的产品质量。当客户产品经过较长的开发和测试周期并实现终端应用后，如果更换 PCB 供应商将会消耗较大的时间和资金成本，并可能影响到生产经营的连续性和稳定性。因此，为保证 PCB 供应的稳定性和可靠性，客户与 PCB 供应商之间一般具有较强的黏性。

受益于在 PCB 样板、小批量板领域多年的深耕，公司已累计服务了过万家企业，为后续公司进一步发展提供了重要的客户资源。

4、强大的技术实力提供重要保障

从技术实力看，公司成立至今，通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术。其中，截至本报告出具之日，公司及子公司已取得专利 204 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 187 项；同时通过在行业内多年的技术沉淀，公司积累了包括选择性局部镀镍金板生产技术、LED 板生产技术、盲埋孔板生产技术、厚铜板生产技术、高精度阻抗和线性电阻板生产技术、高频高速板生产技术、服务器板生产技术、挠性板及刚挠结合板生产技术、高精密多层板生产技术等在内的多项 PCB 生产技术。公司及子公司信丰迅捷兴分别挂牌成立了广东省高精密精

细印制线路板工程技术研究中心、赣州市 HDI（线路板）工程技术研究中心，并形成了多项与公司未来技术发展路线相关的核心技术。

为紧抓行业快速增长的良好机遇，公司近年来加大了技术力量的投入，并逐步开展具有市场竞争力的产品开发。良好的技术研发创新能力是公司不断发展的基石，是为下游客户提供丰富的产品以满足其多样化需求的保障。

（五）项目风险分析

本项目的运营状况将受到宏观环境、下游市场、政策、客户、技术、管理、原材料供应等方面的影响。

1、宏观经济及下游市场需求波动带来的风险及规避

印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其发展与下游行业联系密切，与全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对 PCB 下游行业如工业控制、汽车电子、医疗器械、通信设备、消费电子等行业将产生不同程度的影响，进而影响 PCB 行业的需求。

若下游行业需求波动导致客户 PCB 产品需求下降，且公司未能及时通过调整客户和订单结构来有效应对，将会造成公司销售收入下降，对经营业绩产生不良影响。

2、管理风险

公司处于业务快速成长期，当前业务发展对公司现有的管理团队提出更高的要求，使得公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面也面临更大的挑战。如公司不能有效落实业务整合战略，同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，将可能面临一定的经营管理风险。

3、产品研发与工艺技术革新的风险

印制线路板生产企业需要持续进行研发及工艺改进，保持和提升公司的核心竞争力，保障公司持续发展。

PCB 生产企业通过在生产实践中不断积累和研发，进而形成各自的核心技术。

考虑到未来市场变化、技术变革及公司自身研发过程存在的各种不可预见因素等，未来公司若无法保持对新技术的吸收应用以及对新产品、新工艺的持续开发，公司将面临产品研发与工艺技术落后的风险。

4、原材料价格波动风险

印制电路板的原材料成本占主营业务成本的比重较高。其中，主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和金盐，前述主要原材料受铜价、石油和黄金的价格影响较大。

若原材料价格大幅波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵消原材料成本上涨的压力，又或在价格下降时未能做好存货管理，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

5、募集资金运用的风险

新募投项目达产后将使得公司年产能提升 60 万平方米，带动了公司整体产能的显著提高。但是，新增机器设备之后，固定资产折旧的提升也将提高公司的生产运营成本。若宏观环境发生不利变化，或公司对相关市场开拓不力，将会导致公司面临新增产能不能及时消化的风险，从而对项目投资回报和公司预期收益产生不利影响。

（六）可行性研究结论

变更后募集资金投资项目具有良好的抗风险性，符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性，有利于提升公司综合竞争实力及抗风险能力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。综合评估判断，实施变更后募投项目十分必要且可行。

四、向全资子公司增资的情况

（一）使用募集资金向全资子公司增资

信丰迅捷兴为公司全资子公司，鉴于信丰迅捷兴是变更后募集资金投资项目“年产 60 万平方米智能化工厂扩产项目”实施主体，公司拟使用募集资金 20,005.52 万元及其利息收入、理财收益并扣除相关手续费支出后金额（具体以

账户金额为准）向信丰迅捷兴进行增资，用于募投项目实施。其中 9,000 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积，增资完成后，信丰迅捷兴注册资本将由 1,000 万元增至 10,000 万元，公司仍持有信丰迅捷兴 100%股权，信丰迅捷兴仍为公司全资子公司。公司将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

（二）本次增资对象的基本情况

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="3">信丰迅捷兴电路科技有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">91360722584043636Y</td></tr>
<tr><td>住所</td><td colspan="3">江西省赣州市信丰县工业园区绿源大道</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="3">马卓</td></tr>
<tr><td>企业类型</td><td colspan="3">有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）</td></tr>
<tr><td>注册资本</td><td colspan="3">1,000 万元</td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td colspan="3">2011 年 11 月 15 日</td></tr>
<tr><td>营业期限</td><td colspan="3">2011-11-15 至无固定期限</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="3">线路板及其它电子产品的研发、生产、销售（国家有法律、法规专项规定的从其规定）</td></tr>
<tr><td>股东名称及持股比例</td><td colspan="3">本次增资前后，公司均持有 100%的股权</td></tr>
<tr><td rowspan="6">主要财务数据（注：2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月数据未经审计）</td><td>财务指标（万元）</td><td>2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月</td><td>2020 年 12 月 31 日/2020 年度</td></tr>
<tr><td>资产总额</td><td>25,271.14</td><td>23,954.39</td></tr>
<tr><td>负债总额</td><td>16,223.79</td><td>17,004.33</td></tr>
<tr><td>净资产</td><td>9,047.35</td><td>6,950.06</td></tr>
<tr><td>营业收入</td><td>18,066.57</td><td>25,350.88</td></tr>
<tr><td>净利润</td><td>2,097.29</td><td>2,860.42</td></tr>
</table>

（三）本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对信丰迅捷兴进行增资，是基于公司募集资金投资项目实施的实际需要，有助于推进募投项目的实施，提高募集资金的使用效率增强经营效益和盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，信丰迅捷兴将开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定实施监管。

五、审议程序

公司于 2021 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目变更为“年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目”以及使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需经公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

迅捷兴本次变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

本次变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议批准后方可实施，履行了必要的审批程序。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目及使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目相关事项无异议。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：陈耀　　肖晴

陈 耀　　肖 晴

民生证券股份有限公司

2021年 8月30日